

## SEMICON Japan2023 出展のご案内

会期 : 2023年12月13日(水)～12月15日(金) 10:00-17:00  
会場 : 東京ビッグサイト 菱光社ブース : 東5ホール 5334

平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。弊社はSEMICON Japan 2023に出展致します。

SEMICON Japanは半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでをカバーするエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会です。

弊社では、製造プロセス・品質保証を支えるウェハレベルでの検査・測定に関する製品、化合物半導体向け製品をご案内しております。

会場へお越し頂けました際には、弊社ブースへ是非、お立ち寄り頂ければと存じます。

2023年 11月吉日 (株)菱光社



事前登録用QRコード

### 来場方法

ご入場にあたり、下記URLもしくは左記QRコードより事前のご登録をお願い致します。

<https://semi.eventos.tokyo/web/portal/609/event/7901/users/login/>



登録方法が分からない場合ご参考下さい。→ [登録マニュアル](#)

登録マニュアルQRコード

### 展示製品

#### レビュー検査顕微鏡システム AL1200



レシピに従ってウェハ搬送から検査ポイントの撮影までを自動的に行います。

外観検査装置の各種フォーマットの読み込みが可能、追従AFの採用により、反りのあるウェハにもリアルタイムでピント合わせを行います。

#### 300mmウェハ対応レーザーラマン顕微鏡 RAMAN drive



デバイスの特性・製造プロセスに影響を与える、結晶性やポリタイプの評価をウェハレベルで行えます。

その他にも、ウェハの断層応力の評価や、異物・欠陥のマッピングデータを読み込んで、ターゲット異物の同定なども行えます。

異物はサブミクロンサイズまで分析可能です。

パネル展示

蛍光X線測定装置 FISCHERSCOPE<sup>®</sup> X-RAY XDV<sup>®</sup>- $\mu$  SEMI



非破壊でウエハ上の微細パターン部をEDXRFで金属膜厚・組成比を自動測定するシステムです。

ビーム径を絞れる事からUBMの評価に最適な装置です。

ご要望に合わせたEFEMを構築する事が可能です。

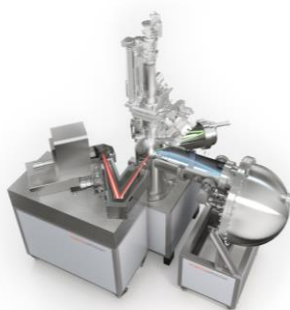
マクロ・ミクロ ウェハー外観検査装置



300mmウェハに対応したマクロ・ミクロ検査装置です。TAIKOウェハ、表裏反転、上位通信 (SECS/GEM300) など、ご要望に合わせてカスタム対応可能です。

マクロ検査の位置をミクロでのレビューに合わせる機能も搭載可能です。

硬X線光電子分光装置 HAXPES Lab



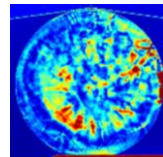
従来の軟X線光電子分光と比較して、表層から50nmの深い検出深度と多様な軌選択性を持ち、物質の表面から内部まで非破壊で化学状態の直接観測を実験室で可能とした装置です。

二次元複屈折評価装置 WPAシリーズ



透明体を光が透過する際に発生する位相差を面で測定します。

SiC・GaNウェハなど光が透過する化合物ウェハにおいて、結晶欠陥の場所をスピーディに確認できます。



ウェハの結晶欠陥評価

重ね合わせ精度測定装置 MAC-R



リソグラフィー工程でのパターニングの重ね合わせ量を測定する装置です。

設計・製造・納品・メンテナンスまで一括したサービスにて、フレキシブルな提案が可能となっております。

マスクレス露光装置 DEシリーズ



最小L/S=2/2 $\mu$ mの解像度を有する露光機です。

最大ウェハサイズは12インチ。マスクが不要なことから、露光デザインの変更が容易に行えます。